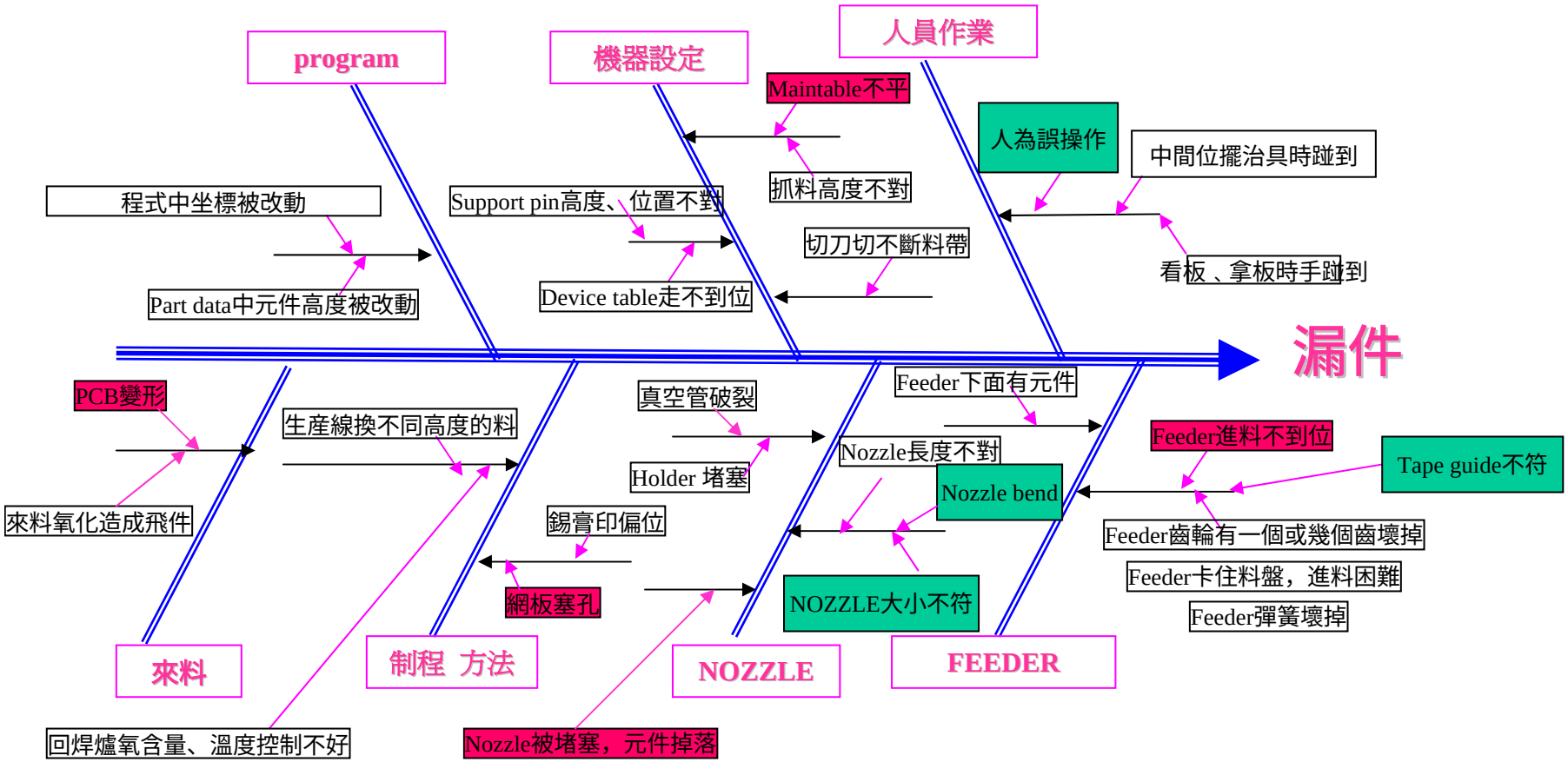
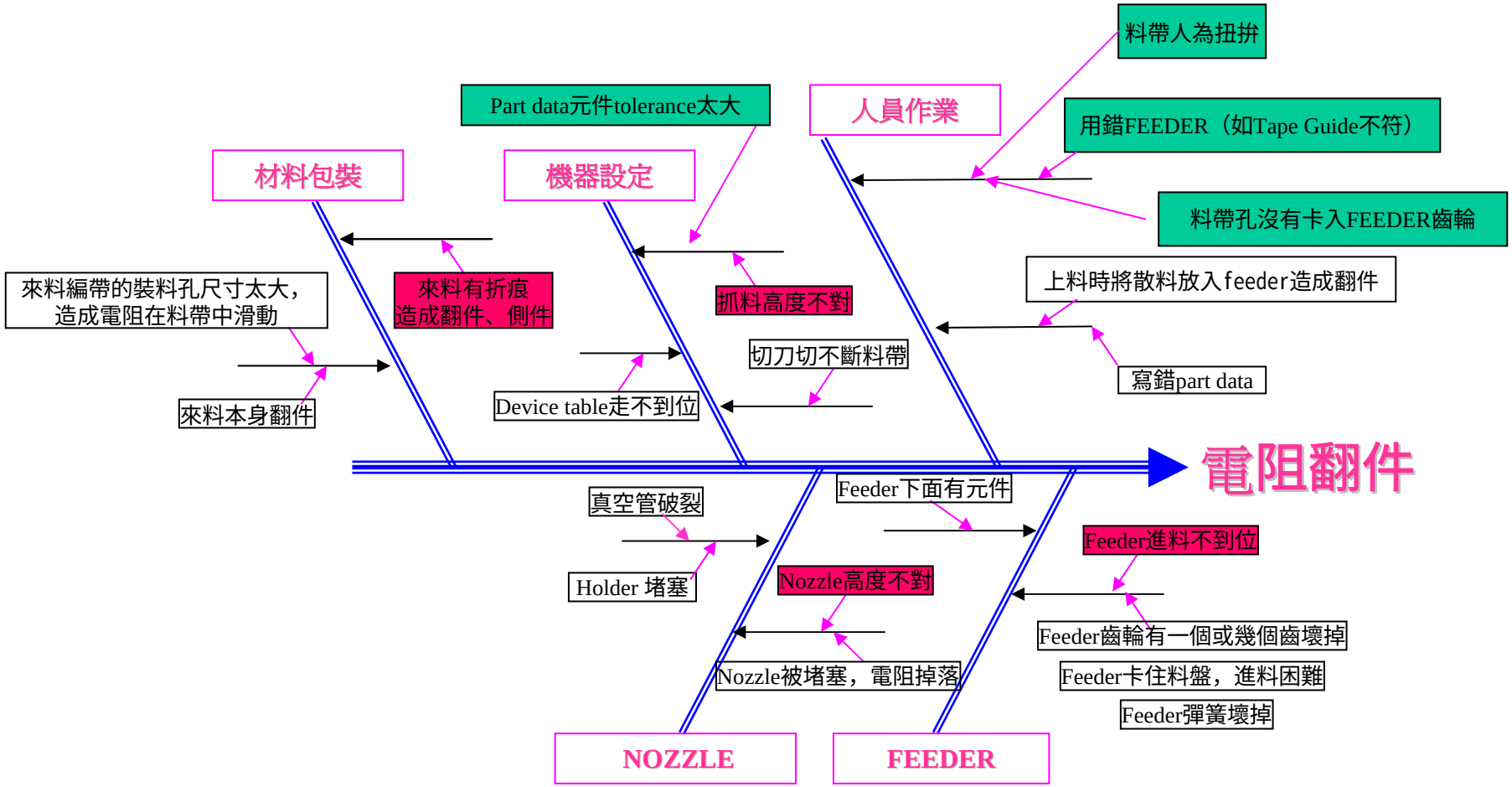
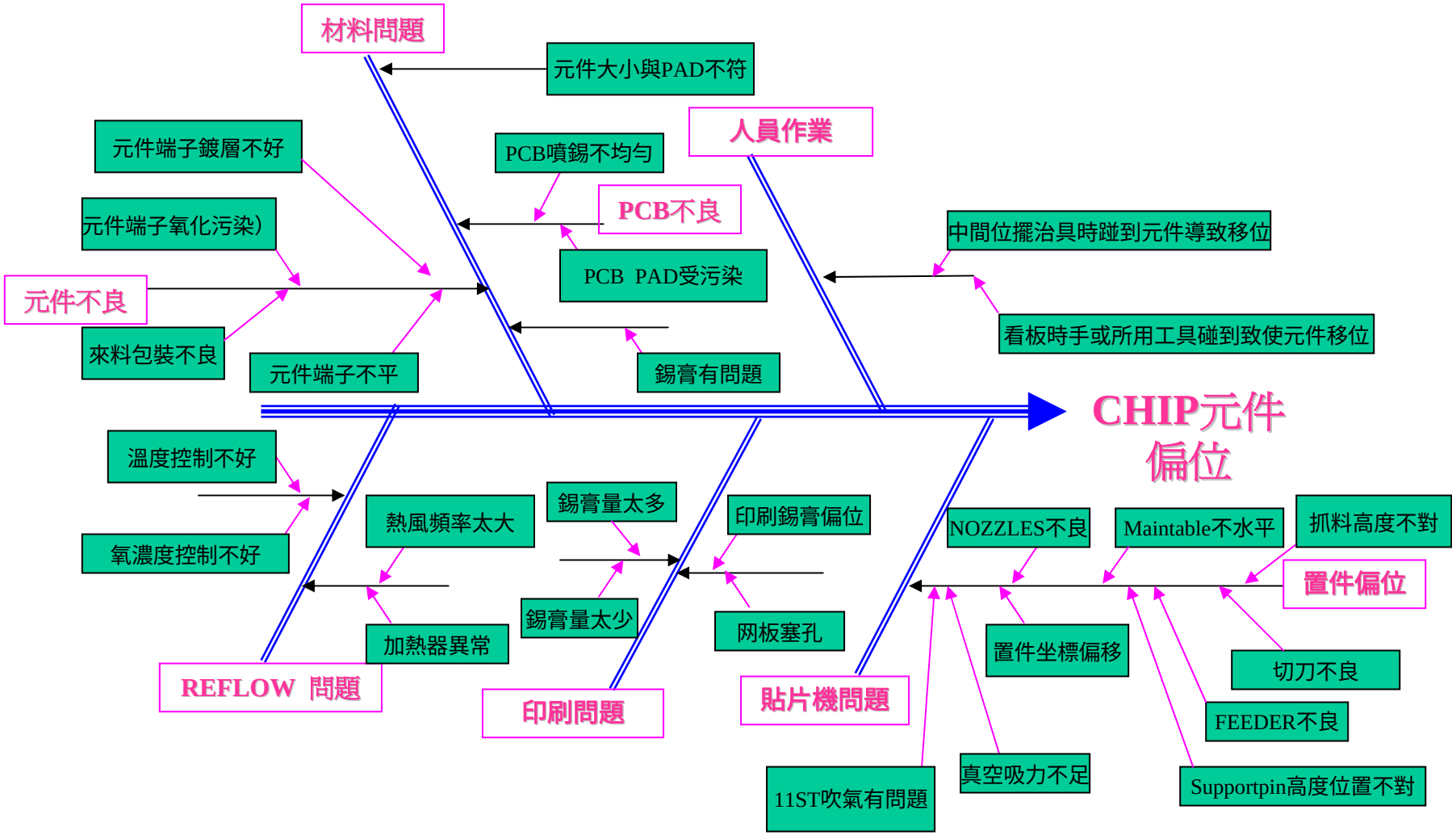

program
機器設定
人員作業
Maintable不平
人為誤操作
中間位擺治具時踫到
程式中坐標被改動
Support pin高度、位置不對
抓料高度不對
切刀切不斷料帶
看板、拿板時手踫到
Part data中元件高度被改動
Device table走不到位
漏件
PCB變形
生產線換不同高度的料
真空管破裂
Feeder下面有元件
Feeder進料不到位
Tape guide不符
Nozzle長度不對
Holder 堵塞
Nozzle bend
來料氧化造成飛件
錫膏印偏位
Feeder齒輪有一個或幾個齒壞掉
Feeder卡住料盤，進料困難
網板塞孔
NOZZLE大小不符
Feeder彈簧壞掉
來料
制程 方法
NOZZLE
FEEDER
回焊爐氧含量、溫度控制不好
Nozzle被堵塞，元件掉落


料帶人為扭拚
Part data元件tolerance太大
人員作業
用錯FEEDER（如Tape Guide不符）
材料包裝
機器設定
料帶孔沒有卡入FEEDER齒輪
來料編帶的裝料孔尺寸太大，
造成電阻在料帶中滑動
來料有折痕
造成翻件、側件
抓料高度不對
上料時將散料放入feeder造成翻件
切刀切不斷料帶
寫錯part data
來料本身翻件
Device table走不到位
電阻翻件
Feeder下面有元件
真空管破裂
Feeder進料不到位
Holder 堵塞
Nozzle高度不對
Feeder齒輪有一個或幾個齒壞掉
Nozzle被堵塞，電阻掉落
Feeder卡住料盤，進料困難
Feeder彈簧壞掉
NOZZLE
FEEDER


材料問題
元件大小與PAD不符
元件端子鍍層不好
PCB噴錫不均勻
人員作業
元件端子氧化污染)
PCB不良
中間位擺治具時踫到元件導致移位
PCB PAD受污染
元件不良
看板時手或所用工具碰到致使元件移位
來料包裝不良
元件端子不平
錫膏有問題
CHIP元件偏位
溫度控制不好
錫膏量太多
印刷錫膏偏位
NOZZLES不良
Maintable不水平
抓料高度不對
熱風頻率太大
氧濃度控制不好
置件偏位
錫膏量太少
网板塞孔
加熱器異常
置件坐標偏移
切刀不良
REFLOW 問題
印刷問題
貼片機問題
FEEDER不良
真空吸力不足
11ST吹氣有問題
Supportpin高度位置不對